

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-009

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度实现营业收入269,000.00万元左右，同比下降7.7%左右。预计实现归属于上市公司股东的净利润为5,850.00万元至8,750.00万元，同比下降87.28%至91.49%。

● 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-12,500.00万元至-9,500.00万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2023年度实现营业收入269,000.00万元左右，同比下降7.7%左右。预计实现归属于上市公司股东的净利润为5,850.00万元至8,750.00万元，与上年同期相比，将减少60,028.99万元至62,928.99万元，同比下降87.28%至91.49%。

2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-12,500.00万元至-9,500.00万元，与上年同期相比，将减少65,153.97万元至68,153.97万元。

(三) 本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润：68,778.99万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：55,653.97万元。

(二) 每股收益：1.02元/股。

三、本期业绩变动的主要原因

(一) 主营业务影响

报告期内，受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，公司所处半导体行业景气度下滑，市场需求疲软。随着市场需求的变化，公司部分产品销售订单有所减少，部分产品价格有所下调；2021年定增募投项目自2022年6月陆续转产，相应的折旧费用等固定成本增加较多；2022年3月收购了嘉兴金瑞泓，产能处于爬坡过程中，相比去年同期亏损增加；公司本期计提了2022年11月发行的33.90亿元可转债财务费用，影响了业绩。综上，公司2023年度业绩下降的主要原因，除了受行业景气度下滑的影响，最主要的是受扩产、兼并收购、可转债等因素的影响。

半导体硅片业务：公司部分募投项目自2022年6月开始陆续转产，相应的折旧费用等固定成本增加较多，但是自2022年下半年以来，受消费电子市场下滑影响，硅抛光片产能利用率有所下降，部分硅片产品价格有所下调。受益于功率半导体需求稳定，公司硅外延片产能利用率充足。由于受经济疲弱影响，衢州基地的12英寸硅片仍处于产能爬坡中，相比去年同期亏损有所增加。

半导体功率器件芯片业务：受益于清洁能源、新能源汽车需求稳定，产能利用率维持高位，相比去年同期销量增长9%，但受部分产品销售价格下调的影响导致毛利率有所下降。

化合物半导体射频芯片业务：受益于产品技术实现突破，射频芯片验证进度

已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户，国产化替代加速，在手订单及出货同比大幅增长；多规格、小批量、多用途、高附加值的产品开始放量。营收同比大幅增长，负毛利率情况有所收窄。

（二）非经常性损益的影响

公司本报告期内非经常性损益有所增加，主要是政府补助增加所致。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024年1月31日